

龍華科技大學資訊管理系學生企業實習

112 學年度 企業合作意願書

媒合日期：112 年 4 月 27 日(四)13:00

| | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|
| 企業名稱 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司 | 營利事業統一編號 | 70848839 |
| 聯絡人姓名 | 劉宴廷/Amber | 聯絡電話 | 0937633352 |
| E-mail | Amber_liu@aseglobal.com | | |
| 聯絡地址 | 桃園市中壢區中華路一段 550 號 | | |
| 實習期間 | 自 112 年 7 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止 | | |

應試方式

採現場面試(媒合)。出席人數：__ 1 __人。車號：__ ALA-3239 __

■採書面申請。聯絡方式:投寄履歷到 Amber_liu@aseglobal.com

實習類別

上學期(112.09.01~113.01.31)

下學期(113.02.01~113.06.30)

■一學年

職稱與專長需求 (可自行增列)

1.僅支領部分津貼(交通、伙食等)，未達基本工資者均視為無薪。

2.若同一職稱同時有支薪與無薪職務，請分兩項列出。

| 職務名稱 | 有/無薪(勾選) | 人數 | 專長需求 | 工作內容 |
|---------------|--|----|------------|--|
| (儲備) 助理工程師 | <input checked="" type="radio"/> 有薪: 30450-55565 (含加班) <input type="radio"/> 無薪: _____ | 10 | 理工/資訊類相關背景 | 1.半導體機台操作/基本改機 2.設備機台維護保養/異常排除 3.工作內容需長時間久站/接觸化學藥品(酒精、丙酮)/英文介面機台/需穿無塵服 |
| 備註 | 1.有薪者請在此註明支薪方式(按時/日/週/月支付)與金額。 2.無薪者如有其他津貼，亦需於此註記。 3.實習期間保險：意外身故殘廢保險 100 萬元，實支實付型傷害醫療保險 10 萬元。 | | | |